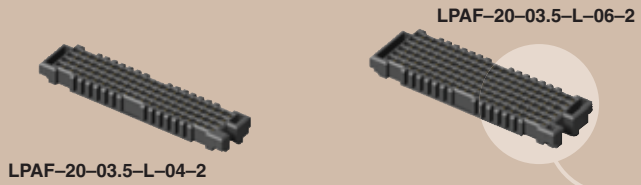




(1,27mm) .050"

LPAF 系列



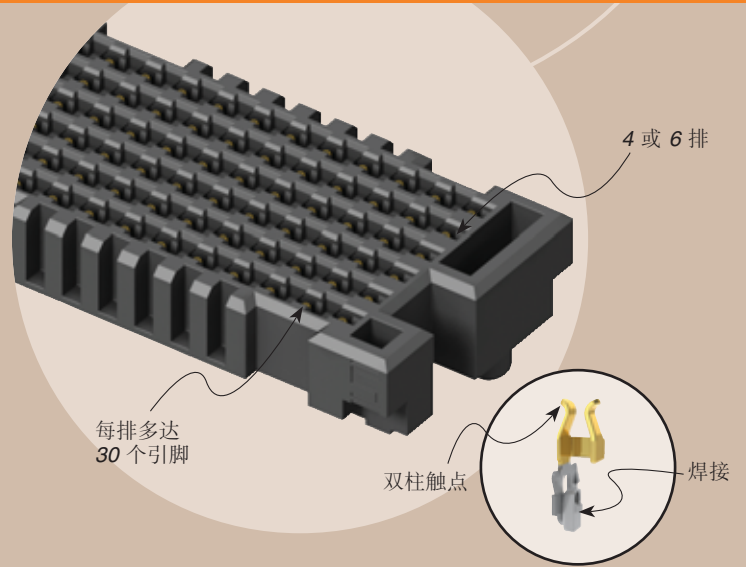
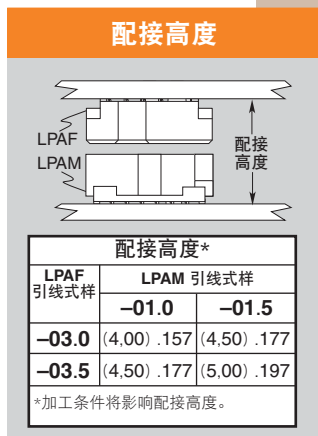
# 高速薄型开放式连接器

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览 [www.samtec.com/LPAF](http://www.samtec.com/LPAF)

- 绝缘体材料：黑色液晶聚合物
- 触点材料：铜合金
- 电镀：在 50μ" (1.27μm) 镍上镀金或锡
- 触点电阻：测试中！
- 额定电流：测试中！
- 性能：测试中！
- 工作电压：测试中！
- 符合 RoHS 规范要求：是可无铅焊接：

配接：LPAM

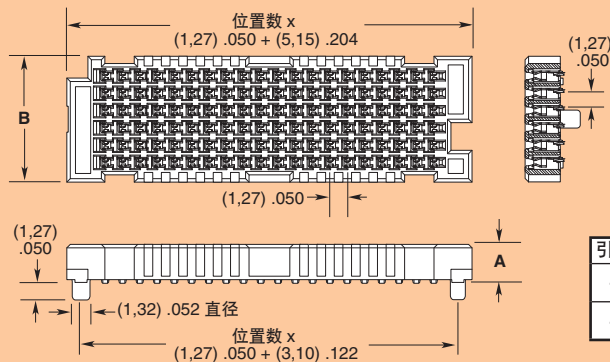


## 还提供

- 锡铅焊接。
  - 其他引脚/排和排数。
  - 其他镀金选项。
- 请致电 Samtec。

<b>LPAF</b>	<b>每排引脚数</b>	<b>引线式样</b>	<b>电镀选项</b>	<b>排数</b>	<b>2</b>	<b>选项</b>	<b>TR</b>
	<b>-10, -20, -30</b> (每排)	<b>-03.0</b> = (3.0mm) .118" <b>-03.5</b> = (3.5mm) .138"	<b>-L</b> = 触点区域镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾上镀雾锡	<b>-04</b> = 四排 <b>-06</b> = 六排	<b>-2</b> = 无铅锡合金 95.5% 锡/3.8% 银/0.7% 铜 焊接	<b>-K</b> = 聚酰亚胺膜 取放垫	<b>-TR</b> = 卷带 封装

排数	B
-04	(6.71) .264
-06	(9.25) .364



注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。